世界の半導体業界リーダーが東京に集結　「ISIG Executive Summit Japan 2026」12 月 2 日・3 日に開催
AI 時代を支える先端半導体製造、先端パッケージング、データセンターの電力・冷却技術、フィジカル AI などを議論

2026 年 11 月 5 日 東京発
ISIG Executive Summit Japan 2026 諮問委員会は、2026 年 12 月 2 日（水）～3 日（木）にヒルトン東京お台場で「ISIG Executive Summit Japan 2026」を開催することをお知らせいたします。

本サミットには、世界の半導体業界を代表する企業の経営幹部、技術開発責任者、研究者、政府関係者などが参加。人工知能（AI）の進化を支える半導体技術やインフラの最新動向、日本の半導体産業が果たす役割について議論します。
今回のテーマは、「Semiconductor Leadership For The AI Era: From Infrastructure To Physical AI（AI 時代の半導体産業のリーダーシップ：インフラからフィジカル AI まで）」です。
2 日間にわたり、基調講演、パネルディスカッション、ビジネスミーティングを実施。先端ロジック半導体製造、AI コンピューティング・アーキテクチャ、先端メモリ、先端パッケージングと光集積技術、計測・検査技術、データセンターの電力供給・冷却技術、フィジカル AI など、半導体産業の将来を左右する重要テーマを取り上げます。

世界の半導体関連企業・研究機関が参加
本サミットには、日本 IBM、ソニーセミコンダクタソリューションズ、AMD、imec、キオクシア、Samsung Electronics、Amkor Technology、Applied Materials、ルネサス エレクトロニクス、Schneider Electric、ダイキン工業、Lam Research、ASMPT、レゾナック、Onto Innovation、Nearfield Instruments、Preferred Networks、東京エレクトロン、Yole Group、McKinsey & Company など、世界の主要企業・研究機関が参加します。
また、経済産業省からの基調講演もあり、日本の半導体産業の競争力強化に向けた産官連携の重要性についても議論します。

再構築が進む日本の半導体産業
日本の半導体産業は現在、過去 30 年間で最大規模ともいえる再構築の途上にあります。
2026 年 4 月、経済産業省は Rapidus に対し、北海道千歳市の 2nm 世代半導体の前工程（IIM-1）および後工程（RCS）の研究開発を支援するため、6,315 億円の追加支援を承認しました。これにより、政府による累計支援総額は 2 兆 3,540 億円に達しています。Rapidus は、日本の主要企業 8 社の出資を受けて 2022 年 8 月に設立され、2027 年の 2nm ロジック半導体の量産開始を目指しています。
一方、日本は先端ロジック半導体に加え、メモリ、材料、パッケージング、精密製造装置、イメージセンサーなどの分野でも高い技術力を有しています。
これらの技術は、AI 向け半導体の製造から電力供給、冷却、大規模な実用化までを支える重要な基盤であり、今回のサミットでも中心的な議題となります。

主要講演とプログラム
初日は、経済産業省 商務情報政策局 情報産業課課長の南部友成氏による講演で開幕し、続いて Rapidus 代表

取締役社長兼 CEO の小池淳義氏が基調講演を行います。
2 日目は、日本 IBM 取締役副社長執行役員 チーフ・サイエンティストの森本典繁氏が、コンピューティングインフラの進化について基調講演を行います。続いて、Rapidus 専務執行役員 Chiplet Solutions 本部長の折井靖光氏が、北海道千歳市で形成されつつあるチップレット・エコシステムについて講演します。

先端パッケージング技術は、両日にわたる主要テーマの一つです。AMD Senior Fellow Advanced Packaging の Deepak Kulkarni 氏、Samsung Electronics Corporate Vice President, Head of Lab の**苅谷隆**氏、Applied Materials Senior Director Semiconductor Products Group の Sarah Wozny 氏らが登壇し、パネルレベルパッケージングをはじめとする最新技術について講演します。

データセンターの電力供給・冷却技術に関するセッションでは、3DIC Research Lab テクニカルディレクターの市川公也氏、Amkor Technology Japan R&D センター長の馬場伸治氏、ダイキン工業 専任役員の石原洋紀氏、Schneider Electric カントリープレジデントである青柳亮子氏が講演します。

フィジカル AI は、締めくくりのセッションで取り上げます。ソニーセミコンダクタソリューションズ インテリジェントシステム開発部門長の柳沢英太氏、Renesas Electronics Head of Physical AI の Brad Rex 氏、McKinsey & Company パートナーの土谷大氏が登壇します。センシングやロボティクスの技術進化から事業機会まで、多角的な視点から、フィジカル AI がもたらす半導体産業の新たな成長の可能性を探ります。

主催者コメント

ISIG 共同創設者兼 CEO Salah Nasri

「日本は長年にわたり、世界の半導体製造において中心的な役割を担ってきました。その重要性は、過去 30 年間のどの時期よりも高まっています。
現在、日本で進んでいる変革は、特定の企業や技術だけにとどまるものではありません。先端ロジック半導体の製造基盤の再構築、長年にわたり蓄積されてきた材料・パッケージング技術、そしてフィジカル AI に不可欠なセンシング・イメージング技術など、多岐にわたっています。
ISIG の役割は、こうした変革を推進する人々と、その技術を必要とする世界の半導体産業の関係者を結びつけることです」。

ISIG Japan General Manager 岩口摩理子

「このサミットは日本の半導体関連企業と海外のエクゼクティブが直接対話し、新たなビジネスや協業につながる機会をつくることを大切にしています。講演やパネルディスカッションに加え、登壇者や参加者同士が実務的な議論をさらに深められることは、ISIG の大きな価値として評価されています。今回も業界の皆様からの助言を踏まえ、人数の拡大よりも、深い交流と継続的な関係づくりにつながる規模を重視して企画しました」。

交流機会を通じて国際的な連携を促進

会場はヒルトン東京お台場（東京都港区台場 1-9-1）。
休憩や昼食時には登壇者と参加者の交流時間を十分に設け、ネットワーキングの深化を図ります。
初日の夕刻には、カクテルレセプションおよびガラディナーを開催します。ガラディナーでは、東京エレクトロン執行役員 コーポレートイノベーション本部 ディビジョンオフィサーの瀬川澄江氏にご挨拶いただきます。

本サミットは、ISIG が 2026 年に世界各地で開催するエグゼクティブサミットシリーズの一環です。同シリーズは各地で定員に達しており、世界の主要市場における半導体業界のリーダーを結ぶ交流・協業の機会となっています。

開催概要

項目	内容
名称	ISIG Executive Summit Japan 2026
日程	2026 年 12 月 2 日（水）・3 日（木）
会場	ヒルトン東京お台場
所在地	東京都港区台場 1-9-1
主催	ISIG (International Semiconductor Industry Group)
テーマ	Semiconductor Leadership For The AI Era: From Infrastructure To Physical AI
公式サイト	https://theisig.com/summits/japan-2026/

ISIG（International Semiconductor Industry Group）について

ISIG は、半導体産業の経営幹部や意思決定者を世界規模で結びつける、エグゼクティブ向けの国際的なネットワークです。2010 年に設立され、IDM（垂直統合型半導体メーカー）、ファウンドリー、ファブレス企業、OSAT（半導体後工程受託企業）、製造装置・材料メーカー、投資家など、半導体産業の幅広い分野の経営幹部が参加しています。

米国、欧州、アジア、中東などの主要地域で招待制のエグゼクティブサミットを開催し、経営戦略、市場動向、重要技術の転換などをテーマに議論する機会を提供しています。

また、サミット以外にも、リーダーシッププログラムや戦略的な意見交換の場を通じて、半導体産業における継続的な交流、協力関係の構築、長期的なパートナーシップの形成を支援しています。

公式サイト： https://theisig.com/summits/japan-2026/

本サミットは招待制です。参加をご希望の方は、公式サイトよりお問い合わせください。なお、サミットは非公開で開催するため、報道関係者の入場・取材は受け付けておりません。

問い合わせ：
ISIG Japan 事務局
斉藤洋子
E-mail: isigjapan@theisig.com

報道関係者お問い合わせ先：
ISIG Head of Marketing & Communications
Maria Rivera
E-mail: maria.rivera@theisig.com